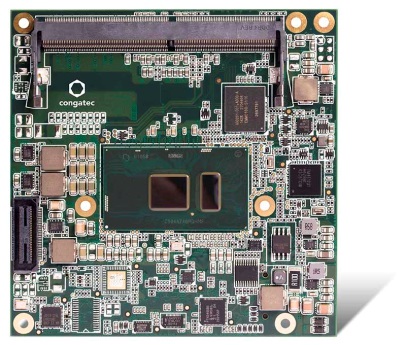
****

|  |
| --- |
| **Contact presse :** |
| **NEXTUAL** |
| Pascale Desmaele |
| Tél : 06 11 48 30 36 |
| [pascale@nextual.fr](mailto:pascale@nextual.fr)  [www.sams-network.com](http://www.sams-network.com) |

**

*Les nouveaux modules compacts COM Express de congatec équipés de la 6e génération de processeurs Inte®l Core (nom de code Skylake) ont été optimisés pour les systèmes confinés sans ventilateur avec une enveloppe thermique configurable de 15watts maximum.*

*Texte et photo disponibles sur :* <http://www.congatec.com/press>

Communiqué de presse

**congatec présente la nouvelle génération   
de modules compacts COM Express   
équipés de la 6e génération de processeurs Intel® Core.**

*De nouveaux niveaux de performances pour construire   
des systèmes embarqués de 15 watts sans ventilateurs*

**Paris, 2 septembre 2015 \* \* \*** congatec AG, acteur de premier plan dans le domaine des modules processeurs embarqués, des cartes SBC (mini-ITX) et des services EDM, présente quatre nouveaux modules compacts COM Express simultanément à l'annonce de la 6e génération de processeurs Intel Core (nom de code Skylake). Ces nouveaux modules possèdent une enveloppe thermique configurable de 15 watts et sont équipés exclusivement de SoC-ULV basse consommation basés sur la nouvelle microarchitecture de 14 nm. Par comparaison avec les modules équipés de processeurs de 5e génération (nom de code Broadwell), les utilisateurs bénéficient de meilleures performances graphiques et générales, d'une meilleure efficacité énergétique et d'E/S haut débit plus nombreuses.

Les modules compacts COM Express de congatec trouveront place dans les applications sans ventilateur des secteurs du médical, de l'imagerie industrielle, les salles de contrôle, les terminaux de boutiques de galerie marchande, les interfaces homme-machine, la robotique, le e-sport, le divertissement, l'audio-visuel professionnel, la surveillance vidéo intelligente, le pilotage de véhicules autonomes, la surveillance du réseau assisté par ordinateur et la signalétique numérique haut de gamme. Autre exemple d'application possible : les systèmes triple-head sans carte graphique, que l'on trouve souvent dans la grande distribution et les kiosques où des systèmes embarqués contrôlent jusqu'à trois distributeurs de billets.

"Nous avons voulu proposer nos nouveaux modules compacts conga-TC170 COM Express en même temps que l'annonce des nouveaux processeurs Intel Core car nos clients veulent disposer de cette nouvelle technologie le plus vite possible", explique Gerhard Edi, CTO de congatec.

"Les nouveaux Computer-on-Modules de congatec équipés de la 6e génération de processeurs Intel Core apportent des performances de traitement graphique et de calcul très élevées, davantage d'E/S haut débit pour une plus grande flexibilité du système et une large gamme d'options (performances, puissance, fonctions) pour répondre à toute application Internet des Objets", a déclaré Samuel Cravatta, directeur des produits du groupe Internet des Objets chez Intel.

Les utilisateurs des nouveaux modules bénéficieront du haut degré de standardisation et de scalabilité des modules COM Express associés à une documentation complète, d'implémentations du driver et d'un important support client de la part de congatec, permettant aux OEM d'intégrer la nouvelle technologie processeur rapidement et efficacement dans leurs applications. Tous les modules sont disponibles sur le long terme et disposent d'un support logiciel d'au moins sept ans. Le support logiciel comprend par exemple des fonctions de sécurité améliorées ainsi que des mises à jour régulières UEFI/BIOS et des patches BSP. Les clients bénéficient donc d'un support fiable tout au long de la durée de vie de leurs applications.

**Les innovations techniques en détail**

Les modules conga-TC170, avec brochage COM Express Type 6, sont équipés de SoC-ULV de la 6e génération de processeurs Intel Core i3/i5/i7. Pour la première fois, ils proposent une enveloppe thermique configurable entre 7,5 et 15 watts, ce qui simplifie la correspondance avec la conception thermique du système. L'alimentation a été également optimisée ce qui, outre la nouvelle microachitecture, contribue à l'efficacité énergétique et autorise un turbo-boost plus important.

Autre nouvelle fonction : la prise en charge de jusqu'à 32 Go de RAM double canal rapide, ce qui apporte davantage de débit dans la version DDR4 et se révèle d'une efficacité énergique plus importante qu'avec la version DDR3.

Le graphique intégré Intel® Gen 9, qui représente une première dans cette nouvelle microarchitecture, alimente jusqu'à trois écrans 4K indépendants à 60 Hz via le DisplayPort 1.2. HDMI Version 2.0 est également pris en charge pour la première fois ainsi que la version 12 de DirectX pour des traitements graphiques 3D Windows 10 plus rapides. Désormais, le décodage mais aussi le codage en HEVC, VP8, VP9 et VDENC est pris en charge par le hard. Les flux de vidéos HD basse consommation dans les deux directions sont possibles pour la première fois. Parmi les autres améliorations : le nombre de ports USB 3.0 (désormais 4) SATA Gen 3 (maintenant 3) PCIe Gen 3 (maintenant 6) ainsi que l'AMT (désormais en version 11.0).

Citons d'autres interfaces compatibles avec le brochage COM Express Type 6 : PEG, Gigabit Ethernet, USB 2.0 8x, LPC plus I2C et UART. Grâce aux interfaces caméra MIPI optionnelles, les capteurs de caméra CSI2 peuvent également se connecter directement. La prise en charge en termes de systèmes d'exploitation concerne tous les SE Linus et les variantes Microsoft Windows y compris Microsoft Windows 10. Des options destinées à simplifier le travail des concepteurs complètent l'offre de congatec : dissipateurs thermiques, cartes porteuses et kits de démarrage ainsi que des modules de gestion des batteries intelligents.

**Versions CPU désormais disponibles**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Processeur |  | Cores/  Threads |  | Smart Cache |  | Clock |  | Turbo Boost |  | TDP/ cTDP |  | Graphics |  | AMT |
| Intel® Core™  i7-6600U |  | 2/4 |  | 4 MB |  | 2.6 GHz |  | 3.4 GHz |  | 15/7.5 W |  | GT2 520 300-1050 MHz |  | 11.0 |
| Intel® Core™  i5-6300U |  | 2/4 |  | 3 MB |  | 2.4 GHz |  | 3.0 GHz |  | 15/7.5 W |  | GT2 520 300-1000 MHz |  | 11.0 |
| Intel® Core™  i3-6100U |  | 2/4 |  | 3 MB |  | 2.3 GHz |  | - |  | 15/7.5 W |  | GT2 520 300-1000 MHz |  | - |

Les datasheets des nouveaux modules conga-TC170 sont disponibles à l'adresse : <http://www.congatec.com/en/products/com-express-type6/conga-tc170.html>

**A propos de Congatec**

Congatec AG, dont le siège est situé à Deggendorf, Allemagne, est un fournisseur de premier plan de modules processeurs industriels utilisant les standards Qseven, COM Express, XTX et ETX, de cartes SBC et de services EDM. Les produits de Congatec peuvent entrer dans un grand nombre d'industries et d'applications comme l'automatisation industrielle, les équipements médicaux, les loisirs, les transports, les télécoms, les tests et mesure et les points de vente.

Parmi les compétences et le savoir-faire technique de Congatec, citons des fonctions BIOS uniques, des pilotes et des BSP (Board Support Packages) complets. Après la phase de design, les clients bénéficient d'un support tout au long du cycle de vie du produit. Les produits de Congatec sont fabriqués par des grands noms du monde de la sous-traitance électronique en respectant les standards de qualité. La société possède des filiales à Taiwan, au Japon, Chine, USA, Australie et République Tchèque. Site web : [www.congatec.com](file:///C:\Users\desmaele\AppData\Local\Microsoft\desmaele\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\desmaele\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\A0UKGA4I\www.congatec.com) ou via [Facebook](http://www.facebook.com/Congatec), [Twitter](https://mobile.twitter.com/congatecAG) and [YouTube](http://www.youtube.com/congatecAE)

congatec AG est membre associé de l'Alliance Intel Internet of Things. Que ce soient des composants modulaires ou des systèmes complets, Intel et les plus de 350 membre de cette Alliance fournissent des solutions évolutives et interopérables qui accélèrent le déploiement d'appareils intelligents et d'analyse globale. Cette collaboration étroite avec Intel et les autres membres de l'Alliance permet d'innover et aider les développeurs à mettre les premières solutions sur le marché.

*Intel and Intel Core are registered trademarks of Intel Corporation in the U.S. and other countries.*

\* \* \*